

2024年3月期 決算説明会

2024年5月17日

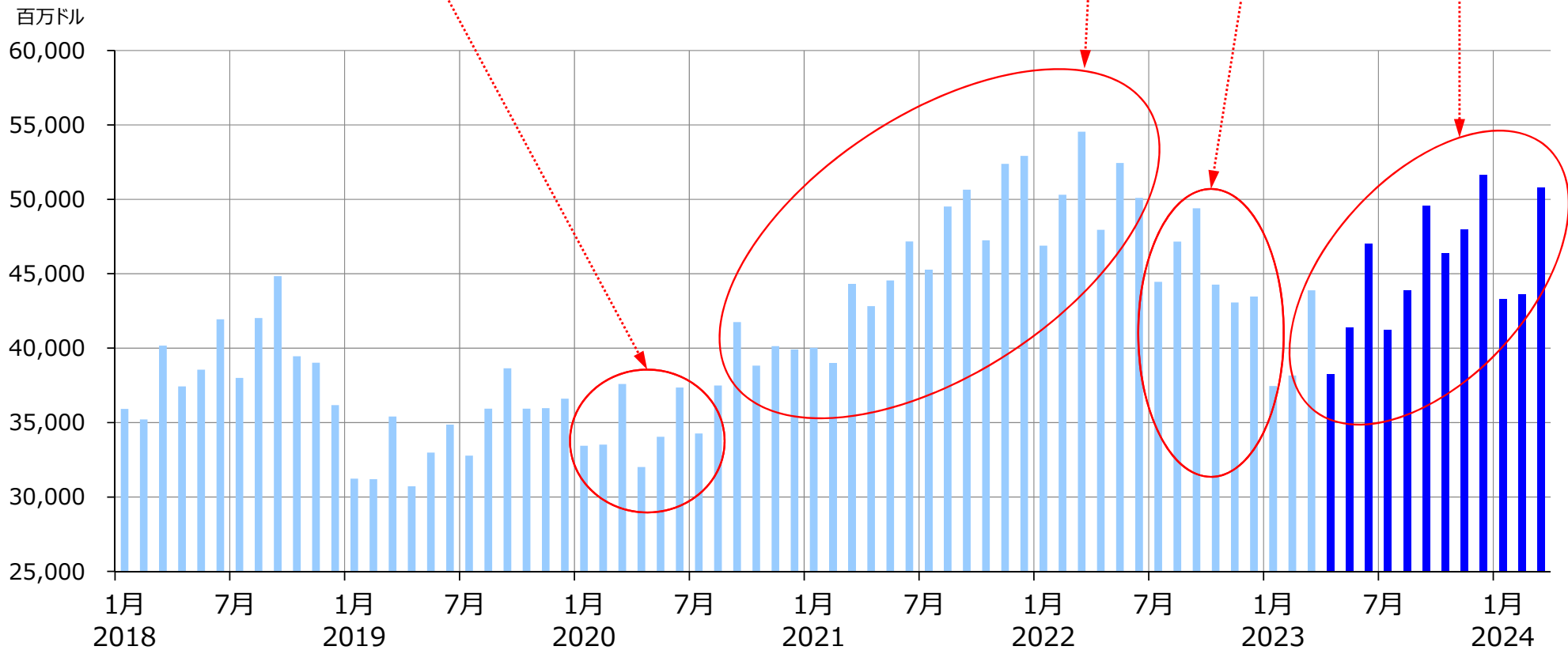
株式会社フジミインコーポレーテッド

市場概況

世界半導体市場動向（月次 実績 ※2024年3月まで）

出所：WSTS（2024/5）

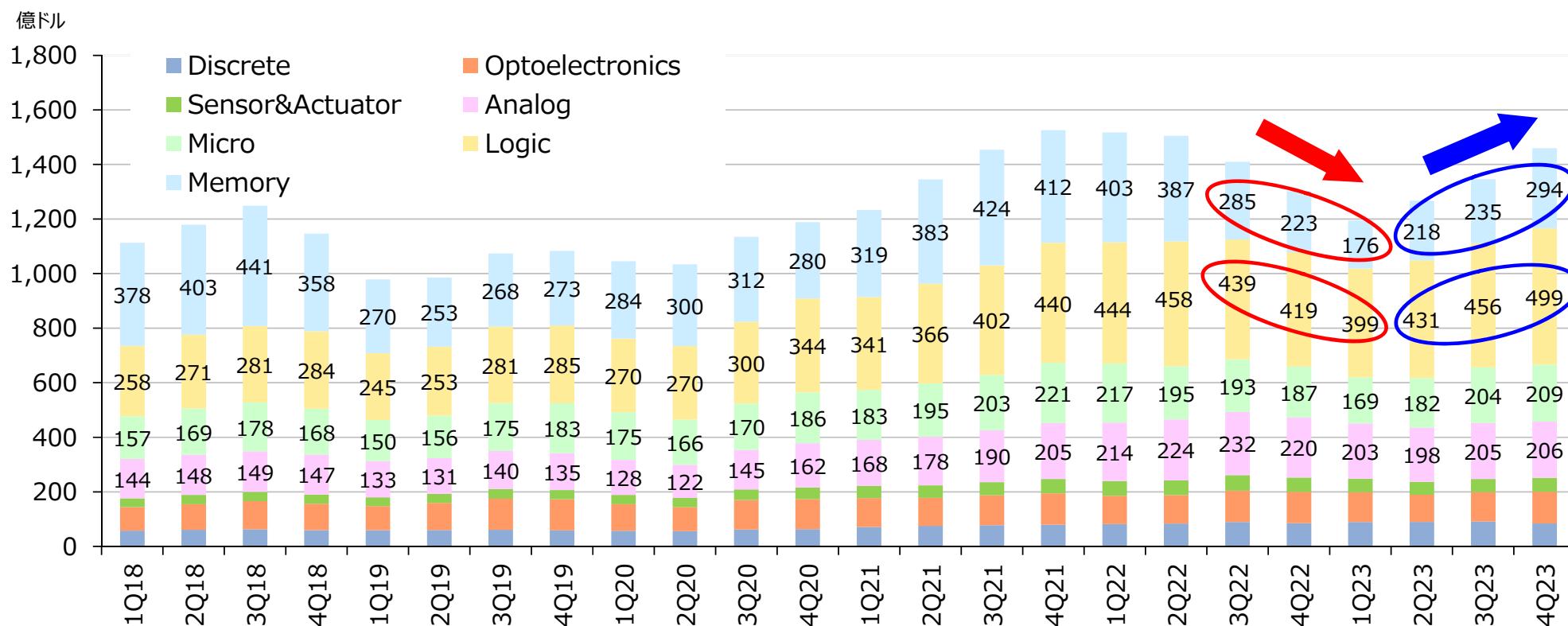
- 2020年、新型コロナの影響で1月より下降 同年8月以降上昇に転じ、強い半導体需要が2022年6月まで継続
- 2022年7月以降、生産及び在庫の調整が見られ減速、23年1月には2年半前（20年8月）の水準を割り込むまで下落、その後、金額ベースでは回復基調を示しているが、数量ベースの本格的な回復に向かうのか、今後の動向に注視が必要



世界半導体市場動向（四半期 実績） 用途別

出所：WSTS

- 22年3Q（7-9月期）から23年1Q（1-3月期）まで半導体市場は縮小が続いた
- 23年2Q（4-6月期）以降は、高価格の生成AI向け半導体の影響で半導体市場は拡大が続いている
- 23年4Q（10-12月期） ロジック(QoQ +9%, YoY +19%) メモリ(QoQ +25%, YoY +32%)

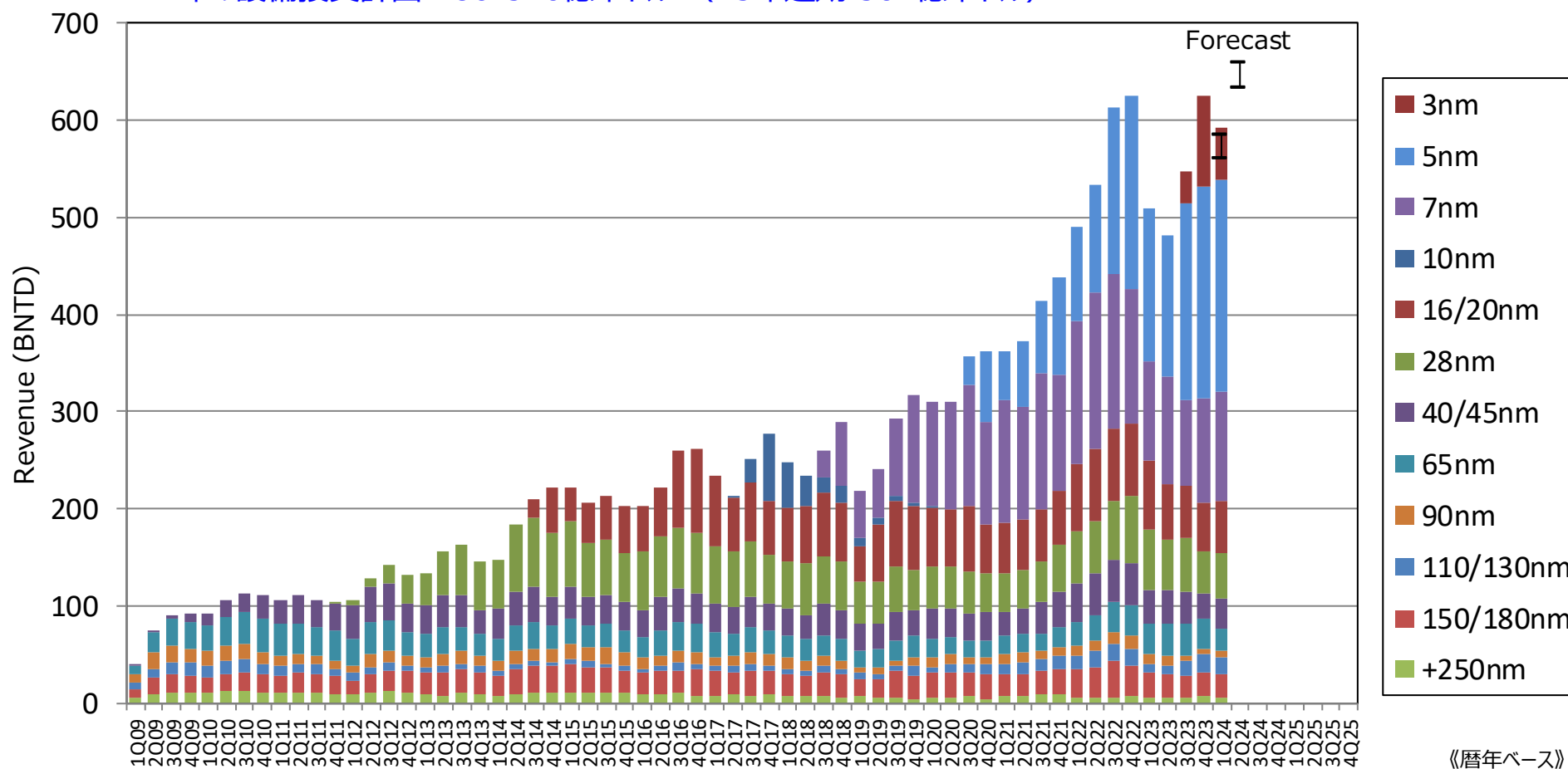


《暦年ベース》

台湾セミコンダクター（TSMC）売上高（2024年1-3月期）

出所：TSMC公開情報よりフジミ作成

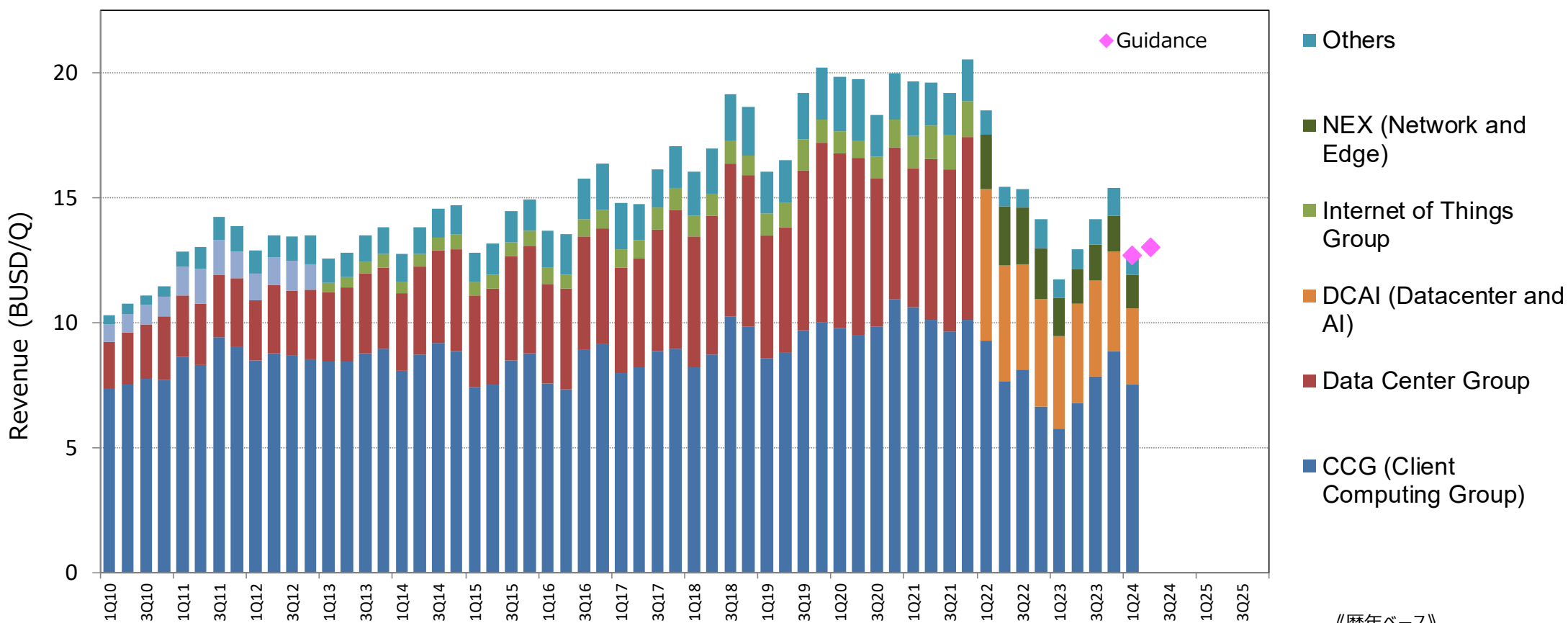
- 24年1Q（1-3月期） 売上高 QoQ -4%, YoY +13% QoQでは、3nmの売上高が減少
- 24年2Q（4-6月期） ガイダンスでは、売上高 QoQ +4% ~ +8%
- 24年の設備投資計画 280-320億米ドル（23年通期 304億米ドル）



Intel 売上高 (2024年1-3月期)

出所：Intel公開情報よりフジミ作成

- 24年1Q (1-3月期) 売上高 QoQ -17%, YoY +9%
主にPC向けの売上高がQoQで減少
- 24年2Q (4-6月期) ガイダンスでは、売上高 QoQ -2%~+6%



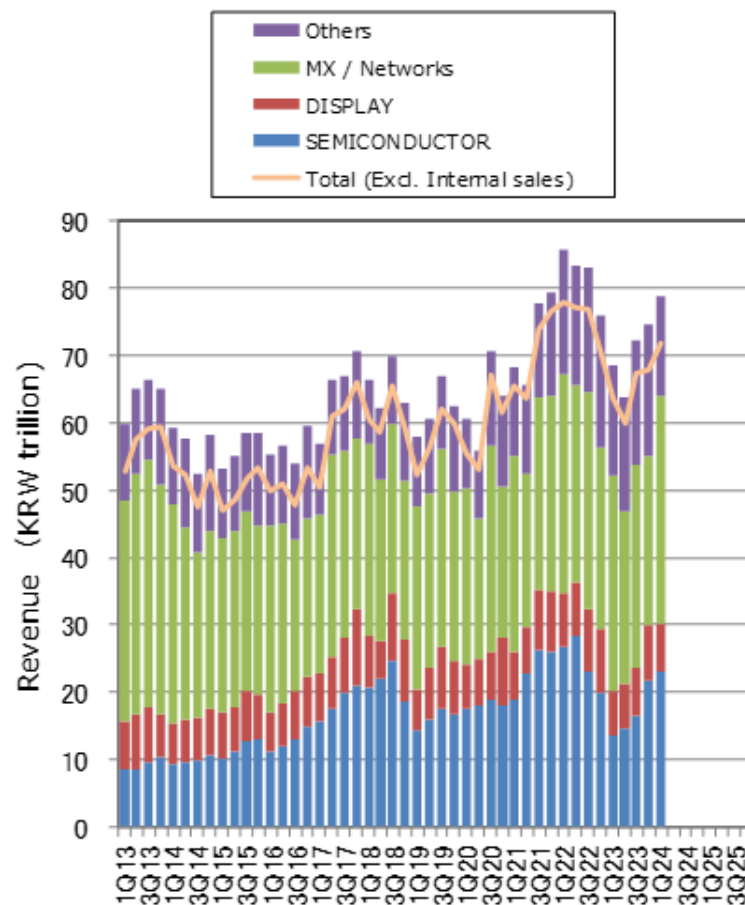
サムスン電子 売上高 (2024年1-3月期)

出所：サムスン電子公開情報よりフジミ作成

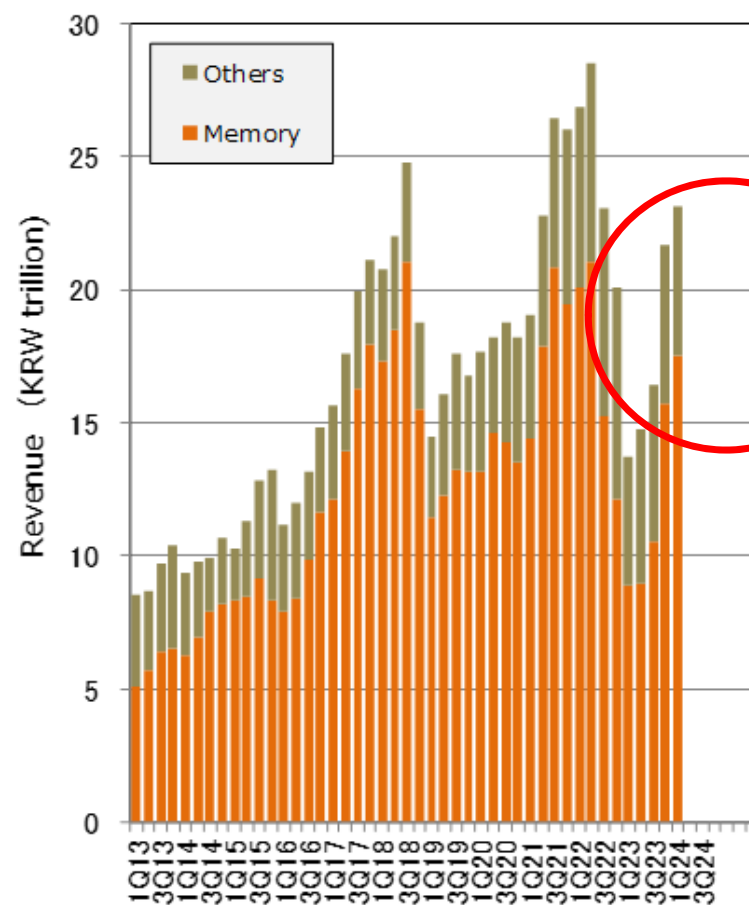
- 半導体事業の24年1Q (1-3月期) 売上高 QoQ +7%, YoY +68%

メモリ：DRAMではDDR5、NANDでは生成AI向けストレージなどの高付加価値製品の売上が増加

<Samsung Total>



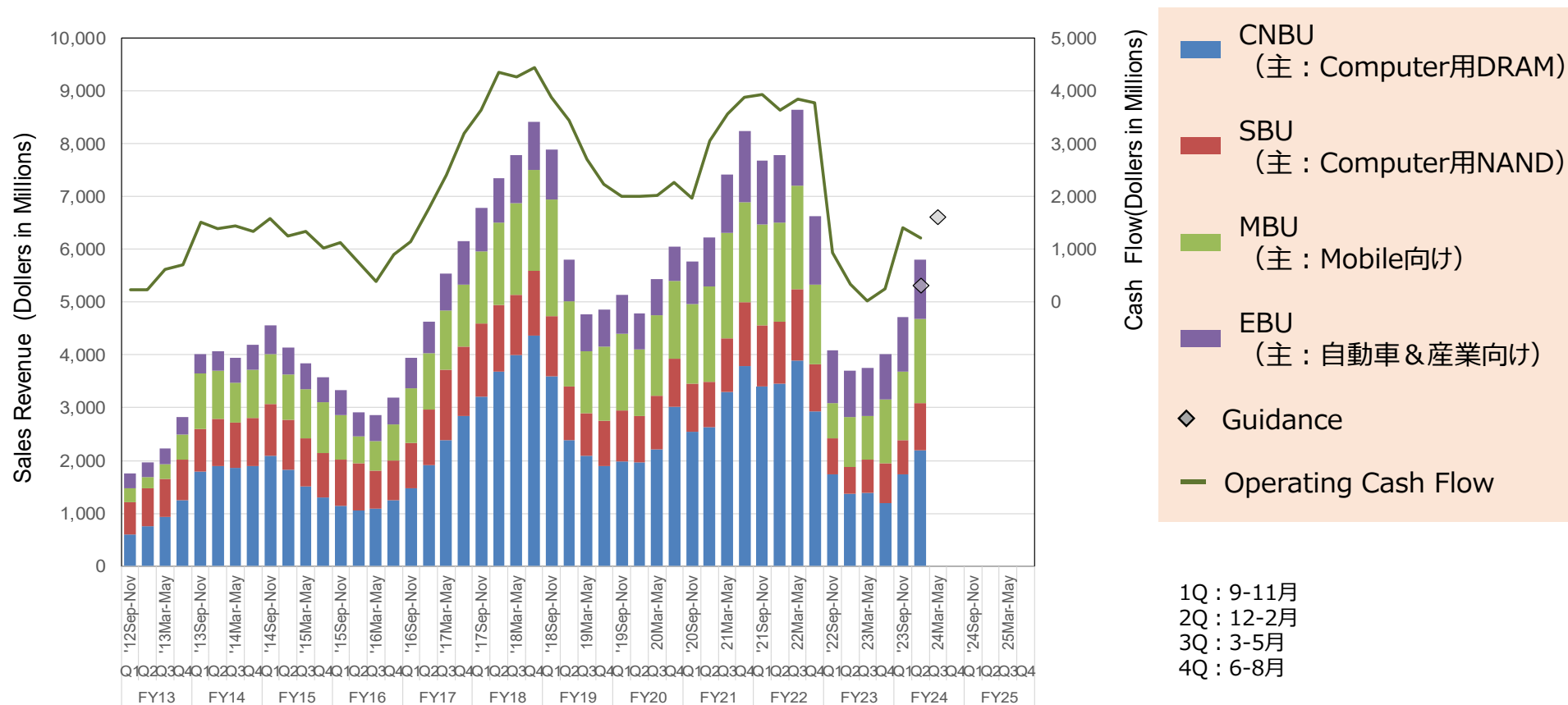
<Semiconductor Division>



《暦年ベース》

マイクロン・テクノロジー 売上高 (2023年12月-2024年2月期)

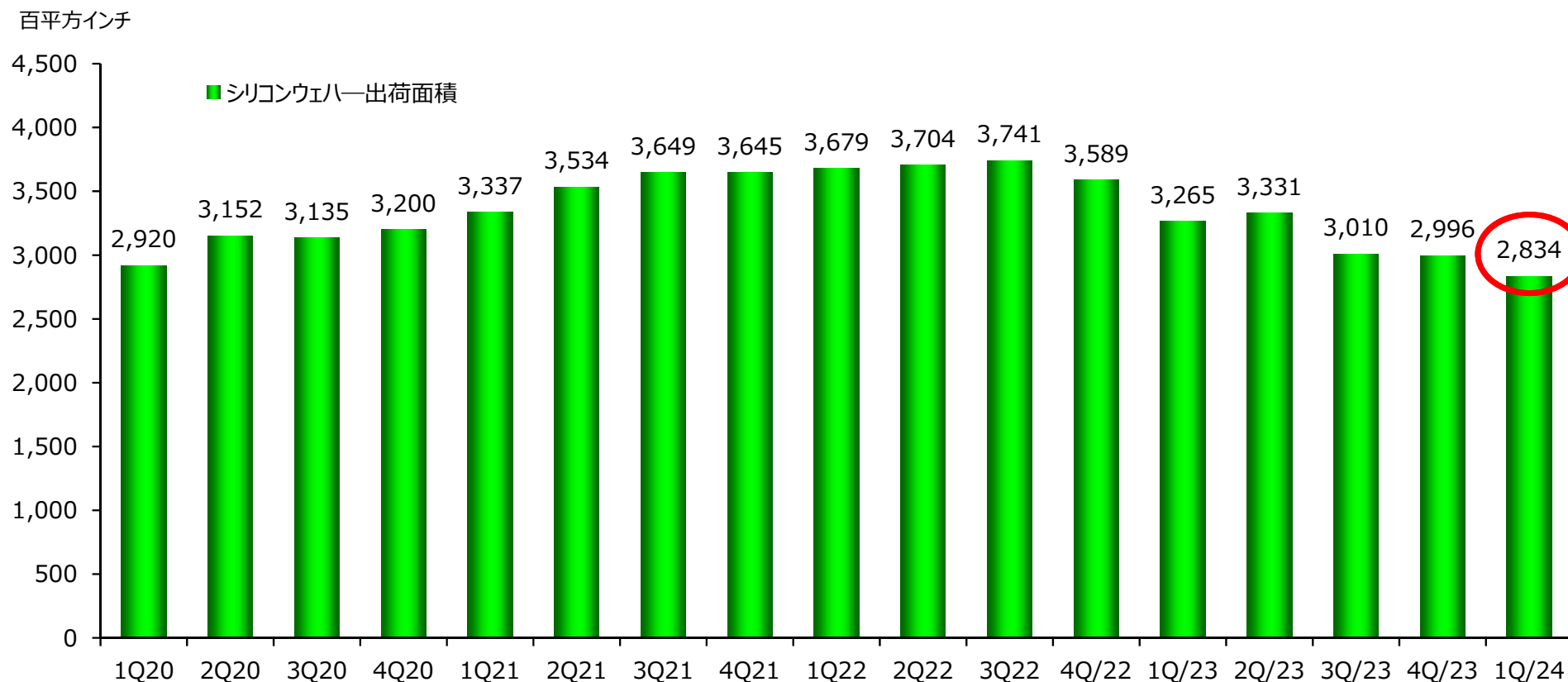
- 23年12月-24年2月期 QoQ +23% YoY +58%
- 24年3-5月期 ガイダンス QoQ +10~17%



シリコンウェハー出荷面積 実績 (四半期)

出所：SEMI (2024/5/9)

- 24年1Q QoQ -5% YoY -13%
- ICファブの稼働率の継続的な低下と在庫調整により、24年1Qはすべてのウェハーサイズでマイナス成長となった



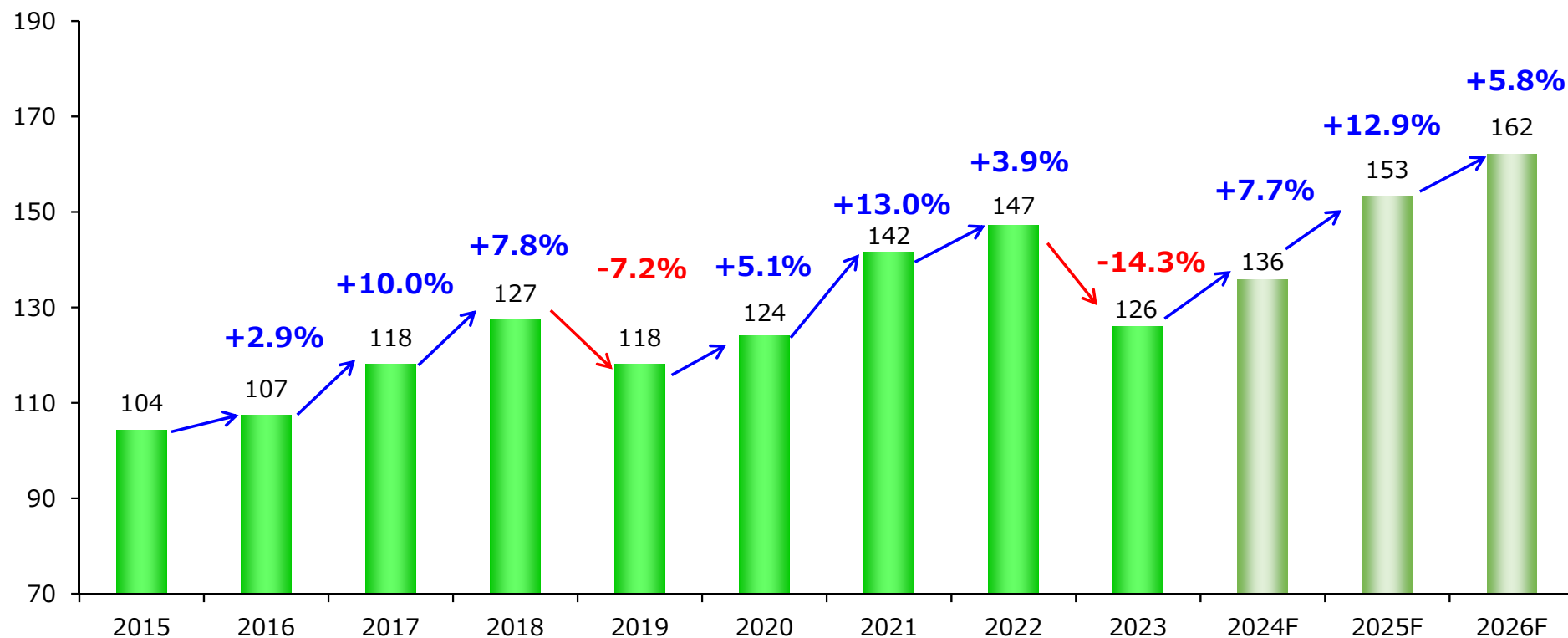
《暦年ベース》

シリコンウェハー需要予測（出荷面積換算 全口径）

出所：SEMI（実績 2024/2/9 予測 2023/10/26）

- 2023年、シリコンウェハー出荷面積はマイナス成長 YoY -14.3%
- 2024年、シリコンウェハー需要予測はプラスに転じる YoY +7.7%

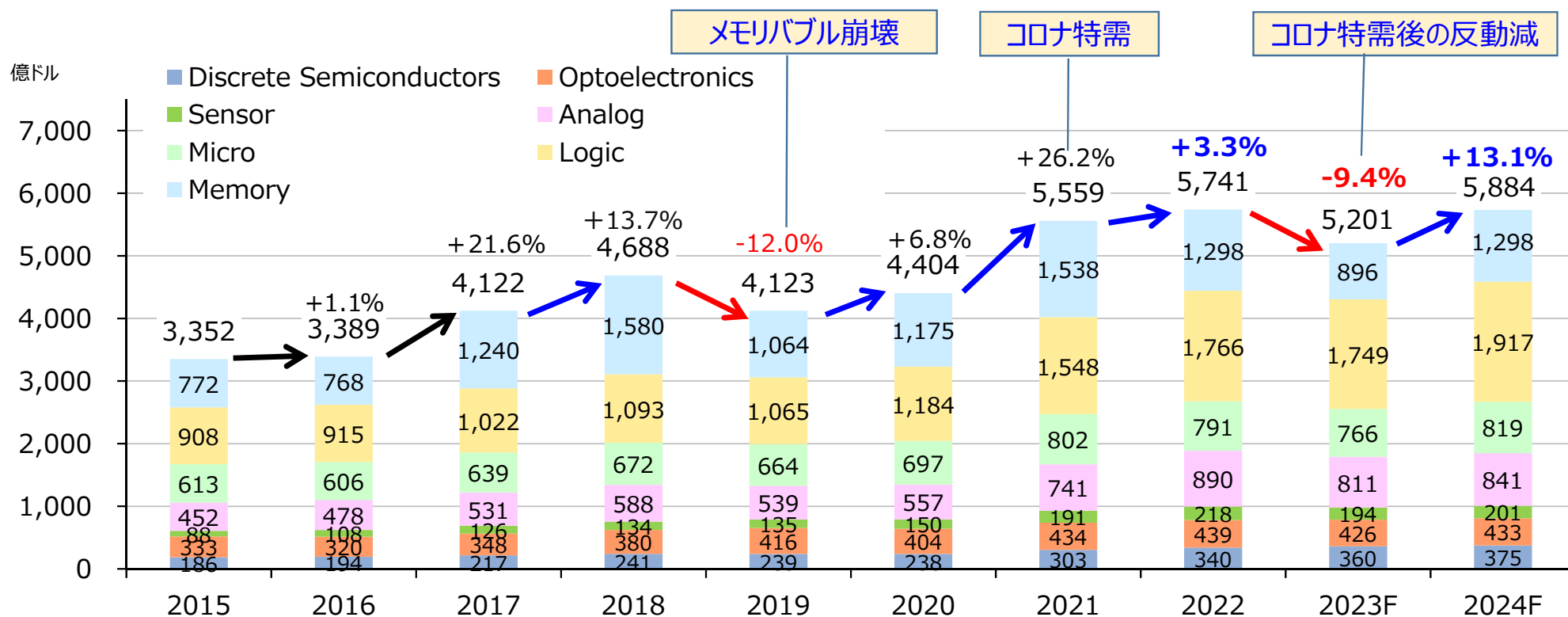
億平方インチ



世界半導体市場動向（年次 WSTS予測） 用途別

出所：WSTS（2023/11/28）

- 2023年の市場予想は、PC・スマホ等の需要低迷により、2022年11月に4.6%から-4.1%へマイナス成長に下方修正、2023年6月には-10.3%に下方修正も、2023年11月には高価値の生成AI向け需要増加もあり-9.4%に修正
- 2024年の市場予想は、生成AI向け需要が引き続き成長するとし、+13.1%を見込む



《暦年ベース》

決算概要

決算概要 (通期実績)

単位：百万円

	23年3月期	24年3月期					
	通期実績	期初予想 ('23/5)	修正予想 ('23/11)	通期実績	前期比	期初予想比 ('23/5)	修正予想比 ('23/11)
売上高	58,394	58,500	49,500	51,423	△11.9%	△12.1%	+3.9%
営業利益 率	13,243 22.7%	12,500 21.4%	7,100 14.3%	8,251 16.0%	△37.7% -	△34.0% -	+16.2% -
経常利益 率	13,595 23.3%	12,700 21.7%	7,650 15.5%	8,958 17.4%	△34.1% -	△29.5% -	+17.1% -
当期純利益 率	10,594 18.1%	9,600 16.4%	5,800 11.7%	6,499 12.6%	△38.6% -	△32.3% -	+12.1% -

(前期比) 半導体向け製品の販売減少に加え、原材料価格上昇の影響を受け、減収減益

(期初予想比) 同様の要因で、下回った

(修正予想比) CMP製品の販売落ち込みは修正予想ほどではなく、他製品の落ち込みをカバーした結果、上回った

為替実績：144円/ドル (23年3月期：135円/ドル)

EBITDAマージン：20.0% (23年3月期：25.6%)

決算概要 (半期実績)

単位：百万円

	23年3月期		24年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	同年上期比
売上高	31,097	27,296	25,352	△18.5%	△7.1%	26,070	△4.5%	+2.8%
営業利益	7,819	5,423	3,949	△49.5%	△27.2%	4,301	△20.7%	+8.9%
率	25.1%	19.9%	15.6%	-	-	16.5%	-	-
経常利益	8,293	5,301	4,430	△46.6%	△16.4%	4,527	△14.6%	+2.2%
率	26.7%	19.4%	17.5%	-	-	17.4%	-	-
四半期純利益	6,155	4,439	3,377	△45.1%	△23.9%	3,121	△29.7%	△7.6%
率	19.8%	16.3%	13.3%	-	-	12.0%	-	-

上期 コロナ特需の反動による半導体市場の調整が継続し、前年上期及び前年下期を下回った

下期 (前年同期比) 半導体市場の調整が継続し、前年同期を下回った

(同年上期比) 半導体市場の調整が継続する中、シリコンウェハー向け製品の売上は減少するも、CMP製品及びハードディスク向け製品が売上を牽引し、同年上期を上回った

業績予想（通期）

単位：百万円

	23年3月期	24年3月期	25年3月期	
	通期実績	通期実績	通期予想	前年比
売上高	58,394	51,423	54,700	+6.4%
営業利益	13,243	8,251	8,500	+3.0%
率	22.7%	16.0%	15.5%	-
経常利益	13,595	8,958	8,700	△2.9%
率	23.3%	17.4%	15.9%	-
当期純利益	10,594	6,499	6,500	+0.0%
率	18.1%	12.6%	11.9%	-

・増収、営業増益予想

・想定為替レート：145円／ドル（前年実績：144円／ドル）

・売上高：半導体の生産の本格的な回復には依然時間を要すものの緩やかな回復を想定し、6.4%の増収を見込む

・営業利益：30億円強の増収の一方で、将来の成長を見据えた先行的な費用増もあり、営業利益は微増を見込む

・経常利益：前期の営業外利益（為替差益+375百万円）がなくなり、経常減益を見込む

・当期純利益：前期の特別損失（減損△245百万円）がなくなり、前期並みを見込む

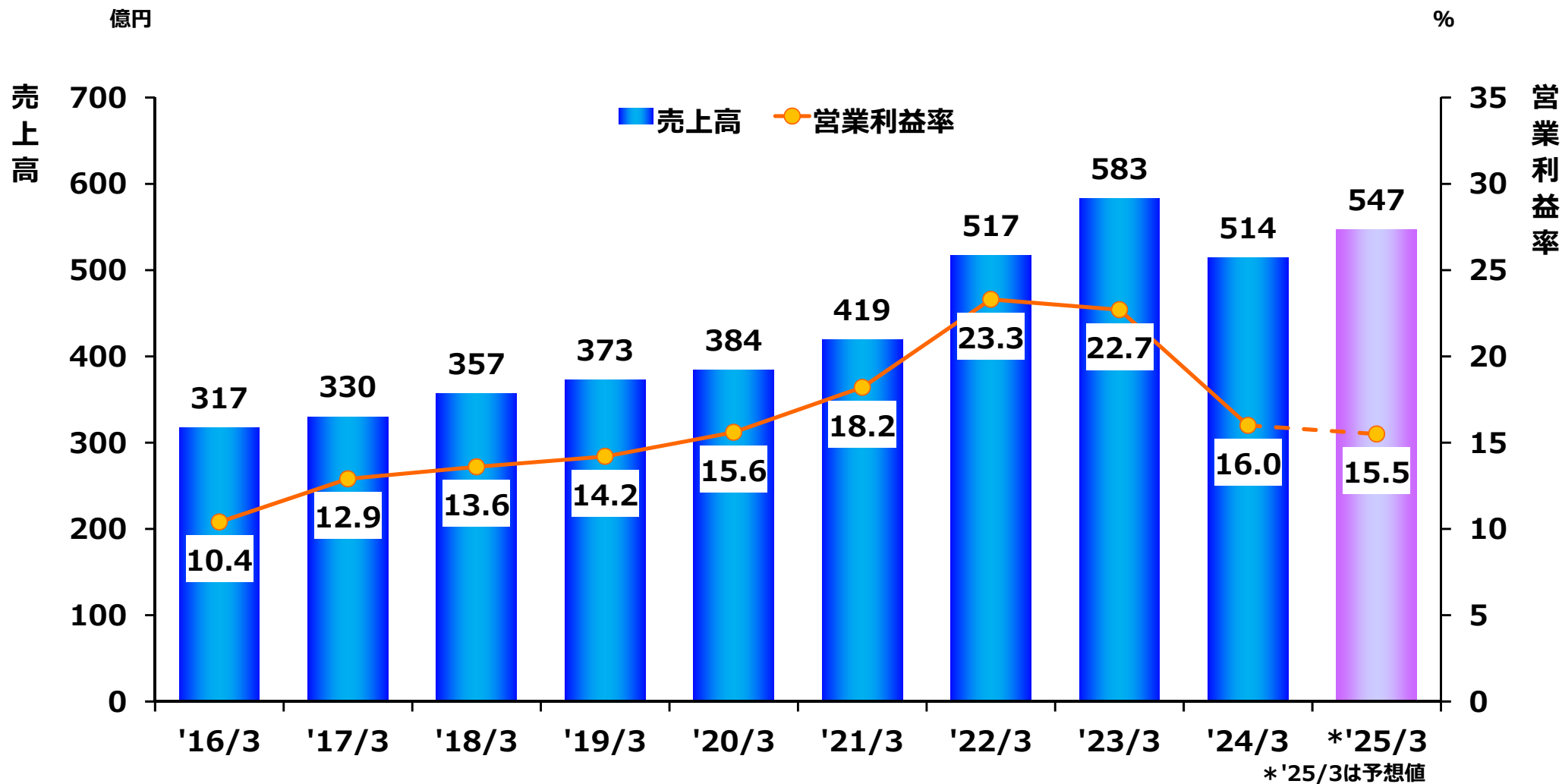
業績予想（半期）

単位：百万円

	24年3月期		25年3月期					
	上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比	同年上期比
売上高	25,352	26,070	27,200	+7.3%	+4.3%	27,500	+5.5%	+1.1%
営業利益	3,949	4,301	4,100	+3.8%	△4.7%	4,400	+2.3%	+7.3%
率	15.6%	16.5%	15.1%	-	-	16.0%	-	-
経常利益	4,430	4,527	4,200	△5.2%	△7.2%	4,500	△0.6%	+7.1%
率	17.5%	17.4%	15.4%	-	-	16.4%	-	-
四半期純利益	3,377	3,121	3,200	△5.3%	+2.5%	3,300	+5.7%	+3.1%
率	13.3%	12.0%	11.8%	-	-	12.0%	-	-

- ・上期から下期にかけて緩やかな売上高の増加を見込む
- ・下期の製品構成の良化とコストダウンにより、上期から下期にかけて利益の増加を見込む

業績推移 (今期予想含む)



用途別売上高

用途別売上高（通期実績）

単位：百万円

		23年3月期	24年3月期					
		通期実績	期初予想 ('23/5)	修正予想 ('23/11)	通期実績	前期比	期初予想比 ('23/5)	修正予想比 ('23/11)
シリコンウエハー	ラッピング	7,054	7,300	5,174	5,474	△22.4%	△25.0%	+5.8%
	ポリシング	13,610	14,000	10,328	9,909	△27.2%	△29.2%	△4.1%
	切断	239	200	197	186	△22.0%	△6.6%	△5.1%
	計	20,904	21,500	15,700	15,570	△25.5%	△27.6%	△0.8%
CMP		28,668	27,100	25,900	27,401	△4.4%	+1.1%	+5.8%
ディスク	アルミディスク	1,468	1,700	1,145	1,379	△6.1%	△18.9%	+20.4%
	ガラスディスク	37	0	5	4	△87.6%	-	△5.6%
	計	1,506	1,700	1,150	1,383	△8.1%	△18.6%	+20.3%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	4,610	5,400	4,200	4,479	△2.8%	△17.1%	+6.6%
	一般工業用(非研磨材)	2,600	2,700	2,450	2,480	△4.6%	△8.1%	+1.2%
	計	7,211	8,100	6,650	6,959	△3.5%	△14.1%	+4.7%
製品売上高		58,290	58,400	49,400	51,314	△12.0%	△12.1%	+3.9%
商品売上高		103	100	100	108	+4.4%	+8.1%	+8.1%
売上高 合計		58,394	58,500	49,500	51,423	△11.9%	△12.1%	+3.9%

用途別売上高（半期実績）

単位：百万円

単位：百万円		23年3月期		24年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	前年同期比	前年下期比	下期実績	前年同期比	同年上期比
シリコンウエハー	ラッピング	3,507	3,546	2,818	△19.6%	△20.5%	2,655	△25.1%	△5.8%
	ポリシング	7,011	6,598	5,487	△21.7%	△16.8%	4,422	△33.0%	△19.4%
	切断	109	129	98	△10.3%	△24.0%	88	△31.9%	△10.4%
	計	10,629	10,275	8,404	△20.9%	△18.2%	7,165	△30.3%	△14.7%
CMP		15,766	12,901	12,962	△17.8%	+0.5%	14,439	+11.9%	+11.4%
ディスク	アルミディスク	987	480	467	△52.7%	△2.9%	912	+89.7%	+95.3%
	ガラスディスク	14	23	3	△75.8%	△84.3%	1	△95.2%	△69.8%
	計	1,002	503	470	△53.1%	△6.6%	913	+81.2%	+94.0%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,298	2,312	2,229	△3.0%	△3.6%	2,249	△2.7%	+0.9%
	一般工業用(非研磨材)	1,330	1,270	1,251	△5.9%	△1.5%	1,228	△3.3%	△1.8%
	計	3,628	3,583	3,480	△4.1%	△2.9%	3,478	△2.9%	△0.1%
製品売上高		31,026	27,264	25,318	△18.4%	△7.1%	25,996	△4.6%	+2.7%
商品売上高		70	32	34	△50.9%	+5.8%	73	+123.9%	+111.6%
売上高 合計		31,097	27,296	25,352	△18.5%	△7.1%	26,070	△4.5%	+2.8%

用途別売上高（通期予想）

単位：百万円

		23年3月期	24年3月期	25年3月期	
		通期実績	通期実績	通期予想	前期比
シリコンウエハー	ラッピング	7,054	5,474	5,650	+3.2%
	ポリシング	13,610	9,909	10,950	+10.5%
	切断	239	186	100	△46.5%
	計	20,904	15,570	16,700	+7.3%
CMP		28,668	27,401	28,900	+5.5%
ディスク	アルミディスク	1,468	1,379	1,500	+8.8%
	ガラスディスク	37	4	0	-
	計	1,506	1,383	1,500	+8.4%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	4,610	4,479	4,900	+9.4%
	一般工業用(非研磨材)	2,600	2,480	2,600	+4.8%
	計	7,211	6,959	7,500	+7.8%
製品売上高		58,290	51,314	54,600	+6.4%
商品売上高		103	108	100	△7.5%
売上高 合計		58,394	51,423	54,700	+6.4%

用途別売上高（半期予想）

単位：百万円

		24年3月期		25年3月期					
		上期実績	下期実績	上期予想	前年同期比	前年下期比	下期予想	前年同期比	同年上期比
シリコンウエハー	ラッピング	2,818	2,655	2,800	△0.7%	+5.4%	2,850	+7.3%	+1.8%
	ポリシング	5,487	4,422	5,450	△0.7%	+23.2%	5,500	+24.4%	+0.9%
	切断	98	88	50	△49.3%	△43.4%	50	△43.4%	0.0%
	計	8,404	7,165	8,300	△1.2%	+15.8%	8,400	+17.2%	+1.2%
CMP		12,962	14,439	14,450	+11.5%	+0.1%	14,450	+0.1%	0.0%
ディスク	アルミディスク	467	912	750	+60.6%	△17.8%	750	△17.8%	0.0%
	ガラスディスク	3	1	0	-	-	0	-	-
	計	470	913	750	+59.4%	△17.9%	750	△17.9%	0.0%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,229	2,249	2,350	+5.4%	+4.5%	2,550	+13.3%	+8.5%
	一般工業用(非研磨材)	1,251	1,228	1,300	+3.9%	+5.8%	1,300	+5.8%	0.0%
	計	3,480	3,478	3,650	+4.9%	+4.9%	3,850	+10.7%	+5.5%
製品売上高		25,318	25,996	27,150	+7.2%	+4.4%	27,450	+5.6%	+1.1%
商品売上高		34	73	50	+44.1%	△31.9%	50	△31.9%	0.0%
売上高 合計		25,352	26,070	27,200	+7.3%	+4.3%	27,500	+5.5%	+1.1%

シリコンウェハー売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

《通期》

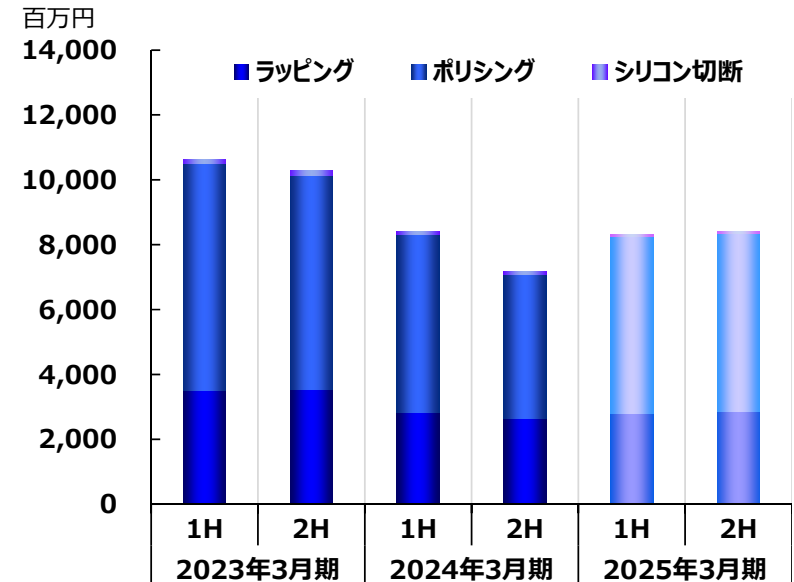
単位：百万円

		23年3月期	24年3月期		25年3月期	
			通期実績	通期実績	前年比	通期予想
シリコンウェハー	ラッピング	7,054	5,474	△22.4%	5,650	+3.2%
	ポリシング	13,610	9,909	△27.2%	10,950	+10.5%
	切断	239	186	△22.0%	100	△46.5%
	計	20,904	15,570	△25.5%	16,700	+7.3%

《半期》

単位：百万円

		23年3月期		24年3月期		25年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
シリコンウェハー	ラッピング	3,507	3,546	2,818	2,655	2,800	2,850
	ポリシング	7,011	6,598	5,487	4,422	5,450	5,500
	切断	109	129	98	88	50	50
	計	10,629	10,275	8,404	7,165	8,300	8,400



(24/3) 半導体市場の調整局面の継続に伴いシリコンウェハーの生産調整が継続し、大幅減収
 (25/3) 半導体の生産の本格的な回復には依然時間を要すると想定するも、シリコンウェハーの生産については緩やかな回復を見込み、増収を予想

* '25/3は予想値

CMP売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

「通期」

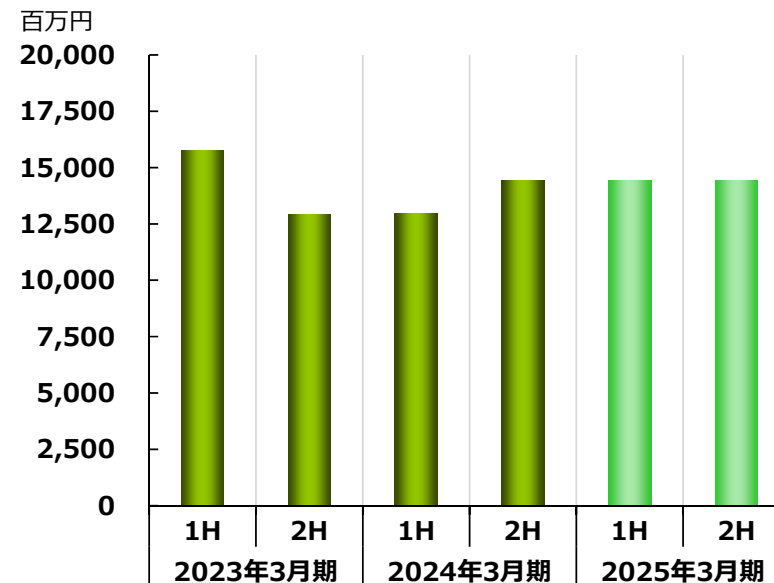
単位：百万円

	23年3月期	24年3月期		25年3月期	
	通期実績	通期実績	前年比	通期予想	前年比
CMP	28,668	27,401	△4.4%	28,900	+5.5%

「半期」

単位：百万円

	23年3月期		24年3月期		25年3月期	
	上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
CMP	15,776	12,901	12,962	14,439	14,450	14,450



(24/3) 上期のマチュアロジック、メモリでの稼働調整を受け、減収
 (25/3) 半導体の生産の本格的な回復には依然時間を要すると想定するも、緩やかな回復を見込み、増収を予想

* '25/3は予想値

ディスク売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

《通期》

単位：百万円

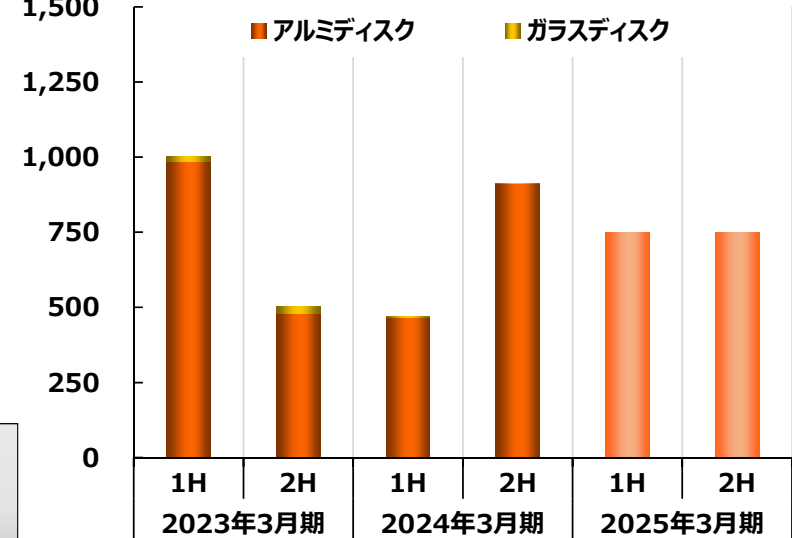
		23年3月期	24年3月期		25年3月期	
			通期実績	通期実績	前年比	通期予想
ディスク	アルミディスク	1,468	1,379	△6.1%	1,500	+8.8%
	ガラスディスク	37	4	△87.6%	0	-
	計	1,506	1,383	△8.1%	1,500	+8.4%

《半期》

単位：百万円

		23年3月期		24年3月期		25年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
ディスク	アルミディスク	987	480	467	912	750	750
	ガラスディスク	14	23	3	1	0	0
	計	1,002	503	470	913	750	750

百万円



(24/3) 上期 HDDの生産及び在庫の調整が継続し減収
 下期 顧客での稼働の回復に加え在庫積み増しもあり増収
 (25/3) 上期・下期 当社製品需要は一定水準で推移すると想定し、通期増収、上下フラットを予想

* '25/3は予想値

機能材・溶射材売上高（通期実績・予想、半期実績・予想）

「通期」

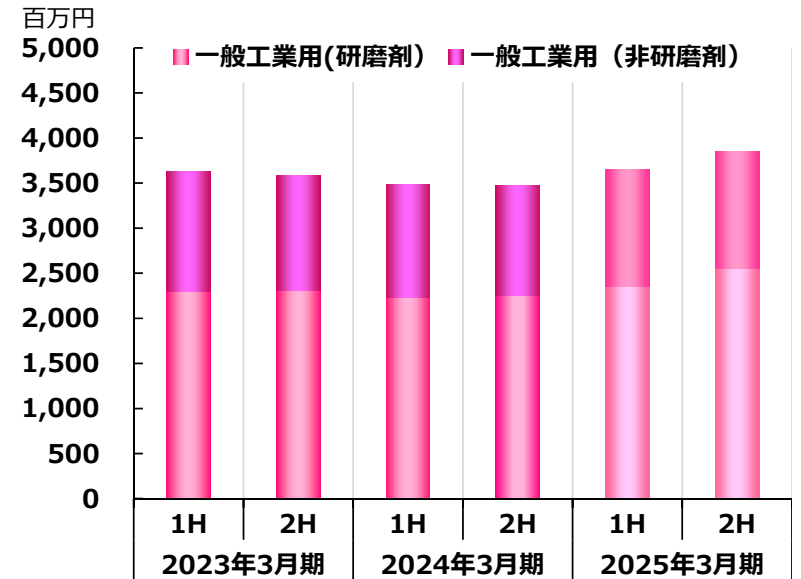
単位：百万円

		23年3月期	24年3月期		25年3月期	
			通期実績	通期実績	前年比	通期予想
機能材・溶射材	一般工業用（研磨材）	4,610	4,479	△2.8%	4,900	+9.4%
	一般工業用（非研磨材）	2,600	2,480	△4.6%	2,600	+4.8%
	計	7,211	6,959	△3.5%	7,500	+7.8%

「半期」

単位：百万円

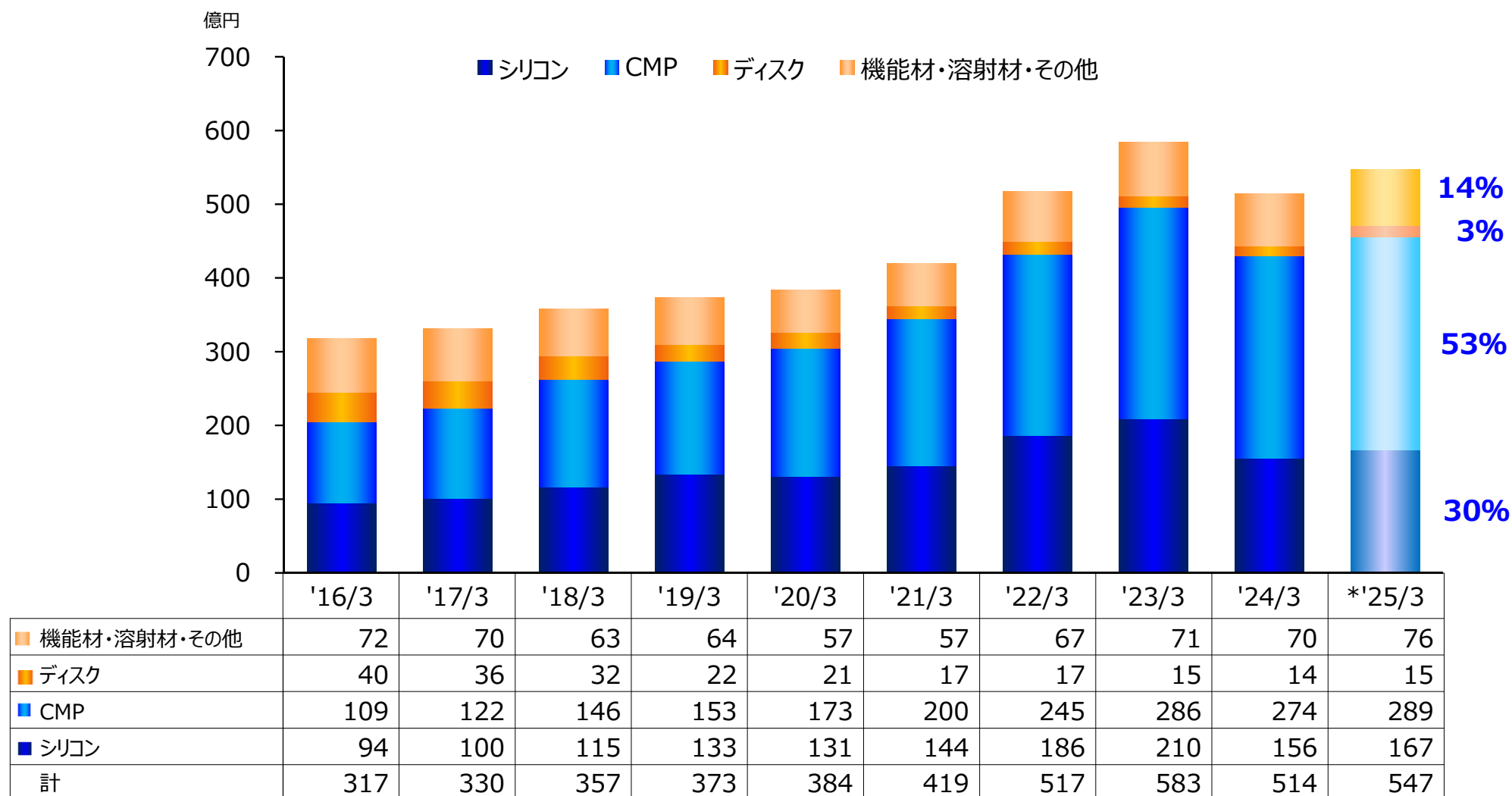
		23年3月期		24年3月期		25年3月期	
		上期実績	下期実績	上期実績	下期実績	上期予想	下期予想
機能材・溶射材	一般工業用（研磨材）	2,298	2,312	2,229	2,249	2,350	2,550
	一般工業用（非研磨材）	1,330	1,270	1,251	1,228	1,300	1,300
	計	3,628	3,583	3,480	3,478	3,650	3,850



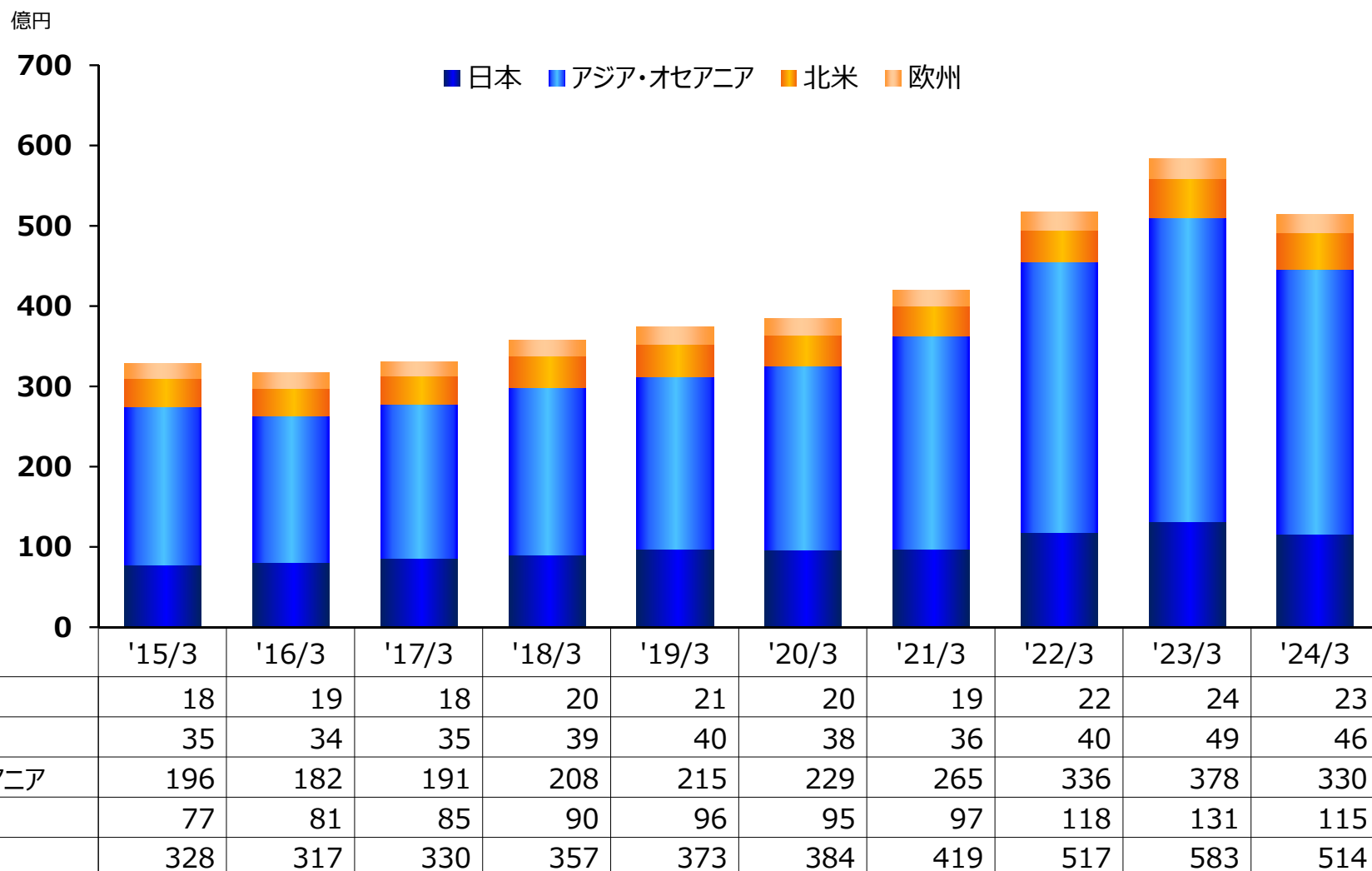
【研磨材】(24/3) 産業機械向けで減収
 (25/3) 自動車及び産業機械向けで増収を予想
 【〃以外】(24/3) 半導体製造装置向け溶射材で減収
 (25/3) 半導体製造装置向け溶射材で増収を予想

* '25/3は予想値

用途別売上高（通期）



地域別売上高（通期 仕向先別）



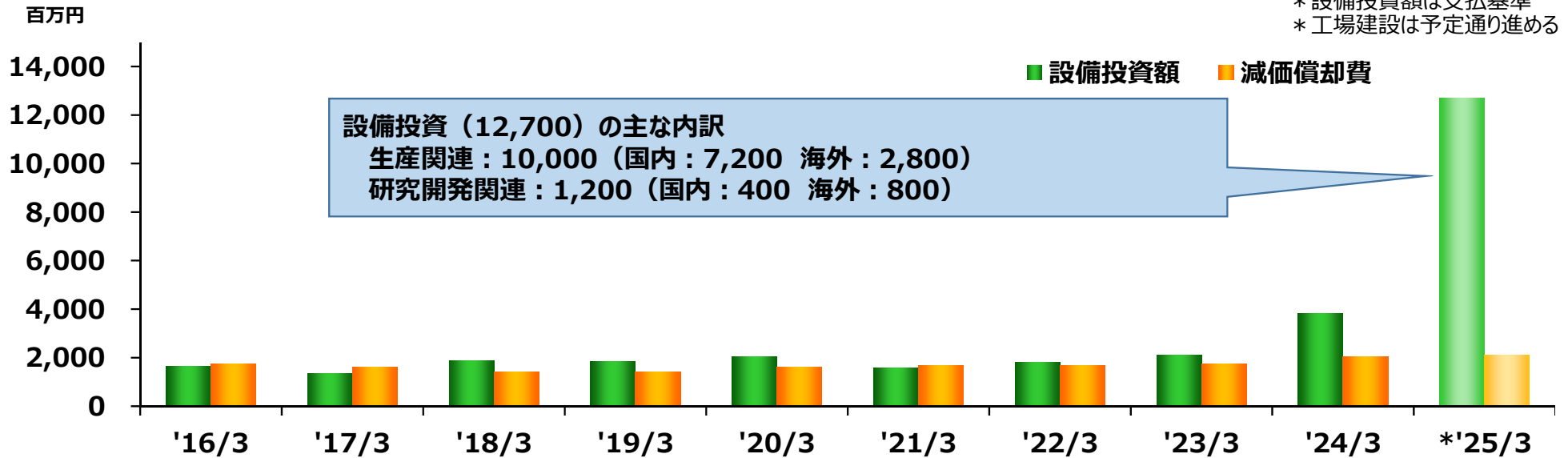
設備投資額
減価償却費
研究開発費

設備投資額・減価償却費（通期実績・通期計画）

単位：百万円

	23年3月期	24年3月期						25年3月期	
	通期実績	期初計画	修正計画	通期実績	前年比	期初計画比	修正計画比	通期計画	前年比
設備投資額	2,094	5,300	5,300	3,838	+83.2%	Δ 27.6%	Δ 27.6%	12,700	+230.8%
減価償却費	1,729	2,200	2,100	2,053	+18.7%	Δ 6.6%	Δ 2.2%	2,100	+2.3%

* 設備投資額は支払基準
* 工場建設は予定通り進める

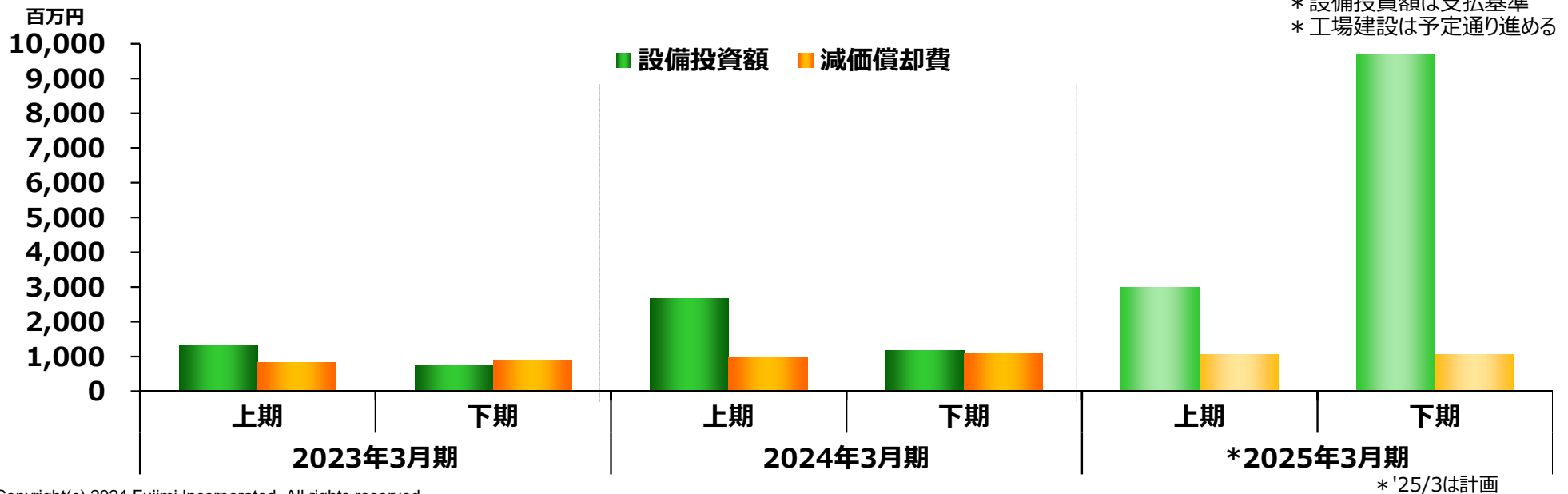


* '25/3は計画

設備投資額・減価償却費（半期実績・半期計画）

単位：百万円

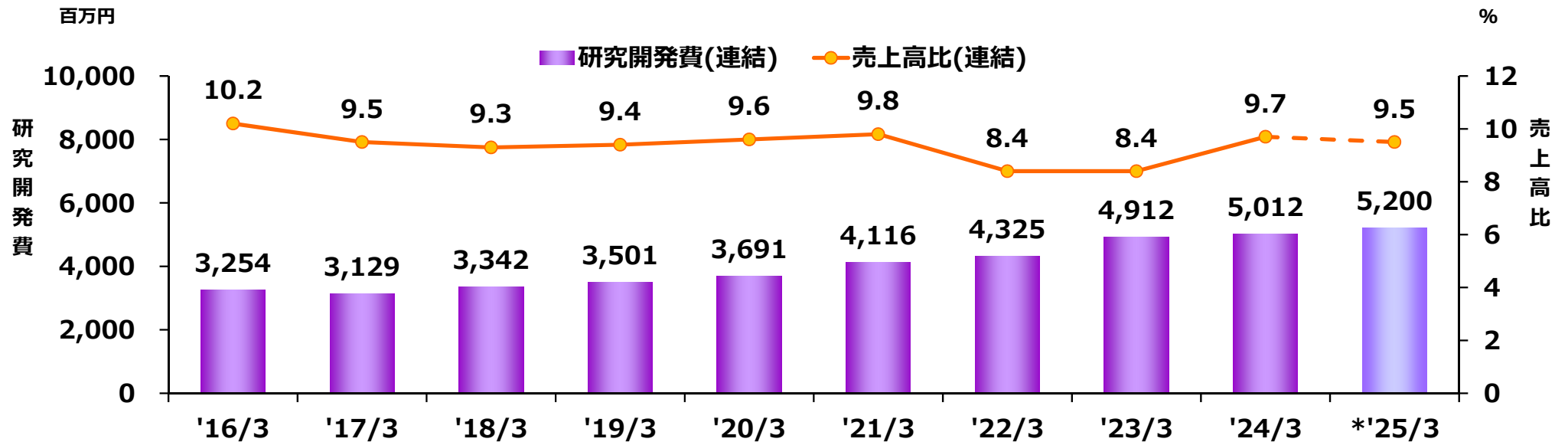
	23年3月期		24年3月期				25年3月期					
	上期 実績	下期 実績	上期 実績	下期 実績			上期 計画			下期 計画		
					前年 同期比	同年 上期比		前年 同期比	前年 下期比		前年 同期比	同年 上期比
設備投資額	1,333	761	2,656	1,182	+55.2%	△55.5%	3,000	+12.9%	+153.7%	9,700	+720.4%	+223.3%
減価償却費	826	903	963	1,090	+20.7%	+13.1%	1,050	+9.0%	△3.7%	1,050	△3.7%	0.0%



研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

単位：百万円

	23年3月期	24年3月期						25年3月期	
	通期実績	通期計画	修正計画	通期実績	前期比	期初計画比	修正計画比	通期計画	前年比
研究開発費	4,912	5,200	5,100	5,012	+2.0%	△3.6%	△1.7%	5,200	+3.8%



*'25/3は計画

損益分析

営業利益増減要因 23/3期実績 → 24/3期実績

売上高 584億円

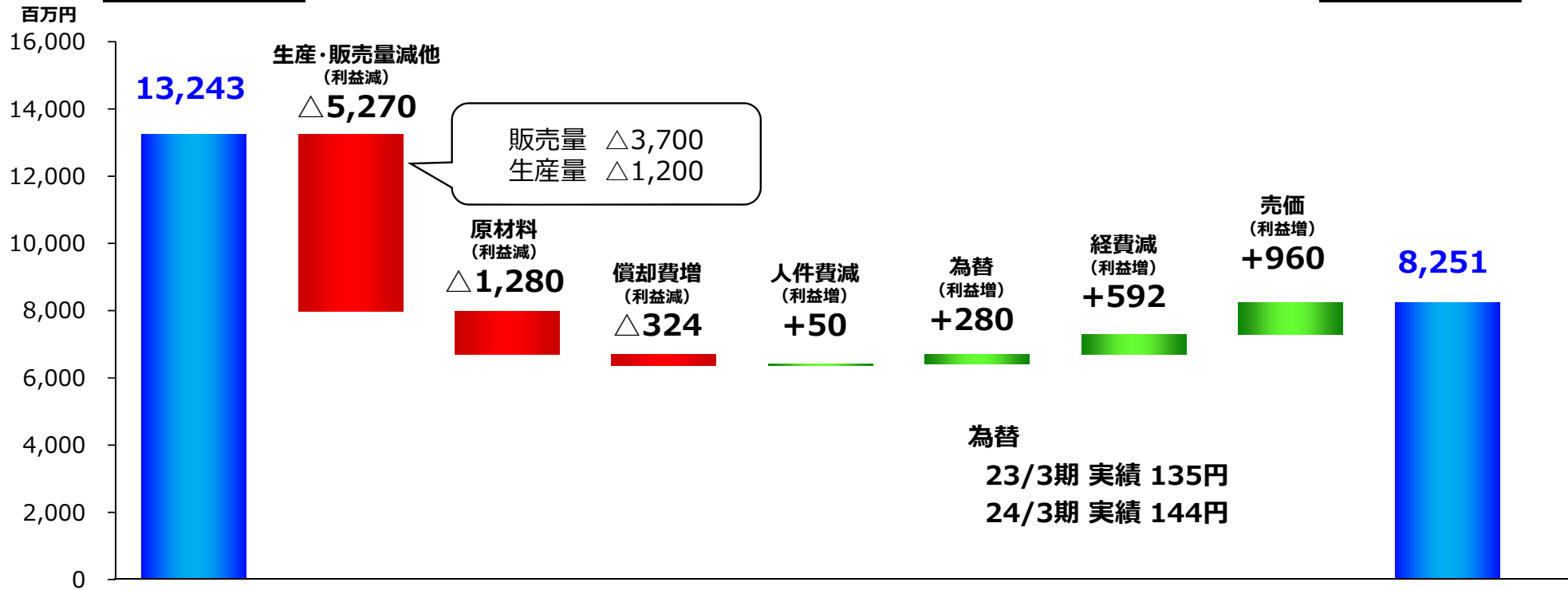
514億円

23/3期
実績

(売上減) $\Delta 6,971$ 百万円

(利益減) $\Delta 4,992$ 百万円

24/3期
実績



営業利益増減要因 24/3期実績 → 25/3期予想

売上高 514億円

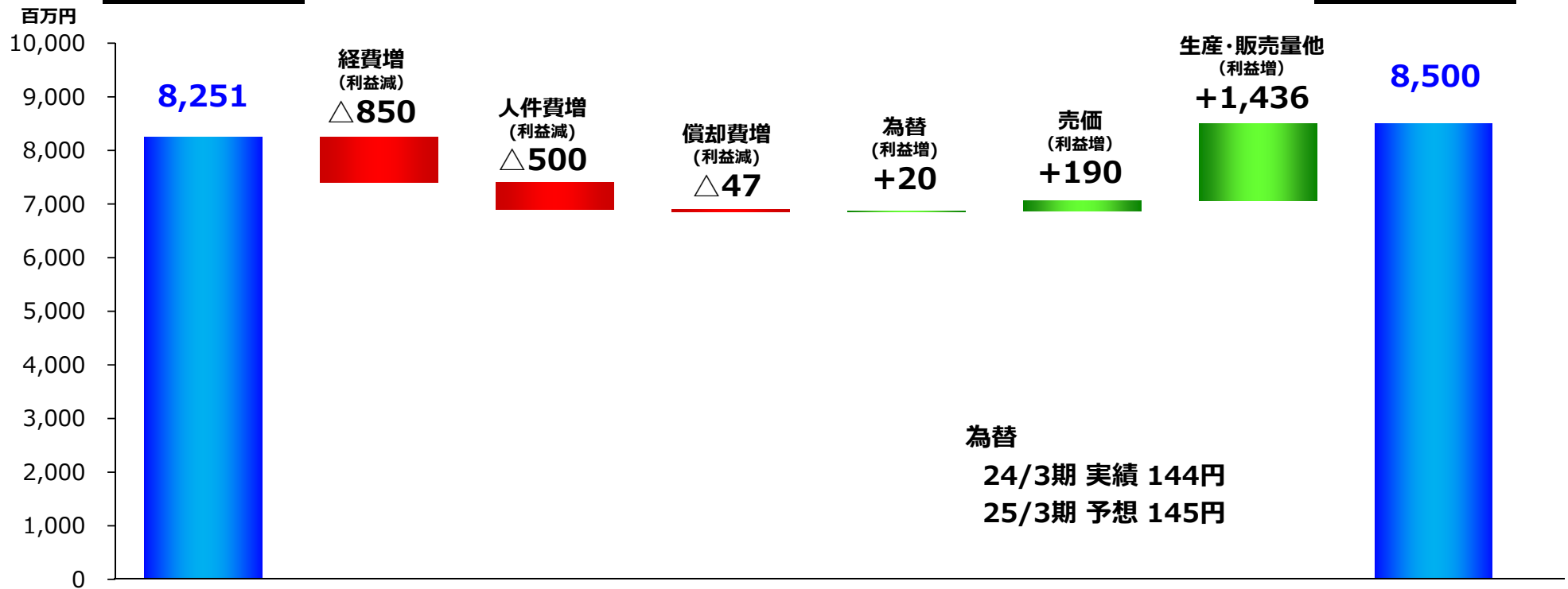
547億円

24/3期
実績

(売上増) +3,277百万円

25/3期
予想

(利益増) +248百万円



株主還元

積極的な株主還元と安定配当の継続

■ 利益配分に関する基本方針

1. 連結配当性向 55%以上 (2024年3月期より)
2. 安定配当の継続

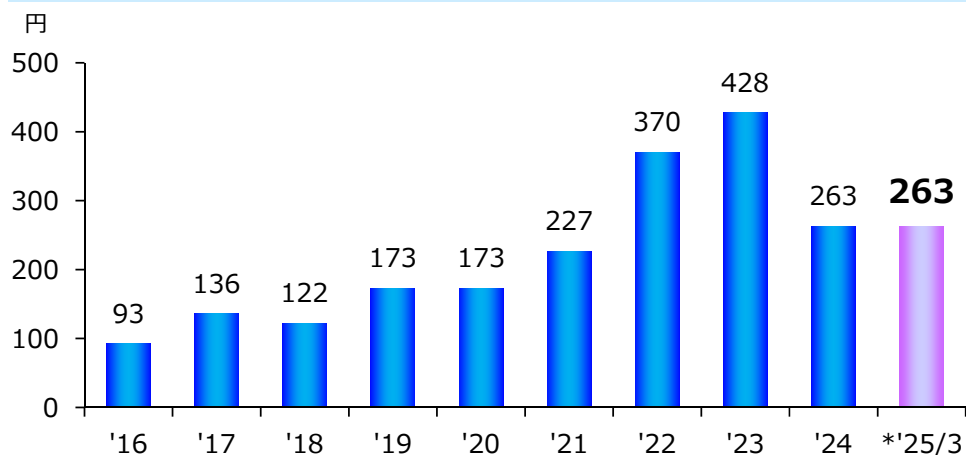
*DOEの配当指標への追加については検討継続

■ 1株当たり配当金 2025年3月期は配当維持

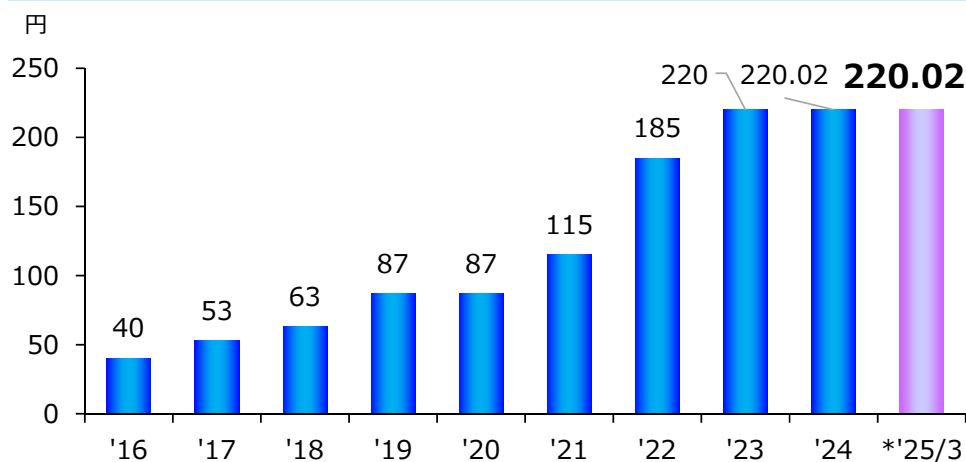
	2023/3月期		2024/3月期 分割実施				2025/3月期	
	期初予想 2022/5/31	実績 2023/5/10	期初予想 2023/5/10		実績 2024/5/13		期初予想 2024/5/13	
			3分割前	3分割後	3分割前	3分割後	3分割前	3分割後
中間配当金	95円	110円	110.01円	36.67円	110.01円	36.67円	110.01円	36.67円
期末配当金	105円	110円	110.01円	36.67円	110.01円	36.67円	110.01円	36.67円
年間配当金	200円	220円	220.02円	73.34円	220.02円	73.34円	220.02円	73.34円
配当性向	49.4%	51.4%	56.7%		83.7%		83.7%	
目標配当性向	50%以上		55%以上				55%以上	

積極的な株主還元と安定配当の継続（分割前基準）

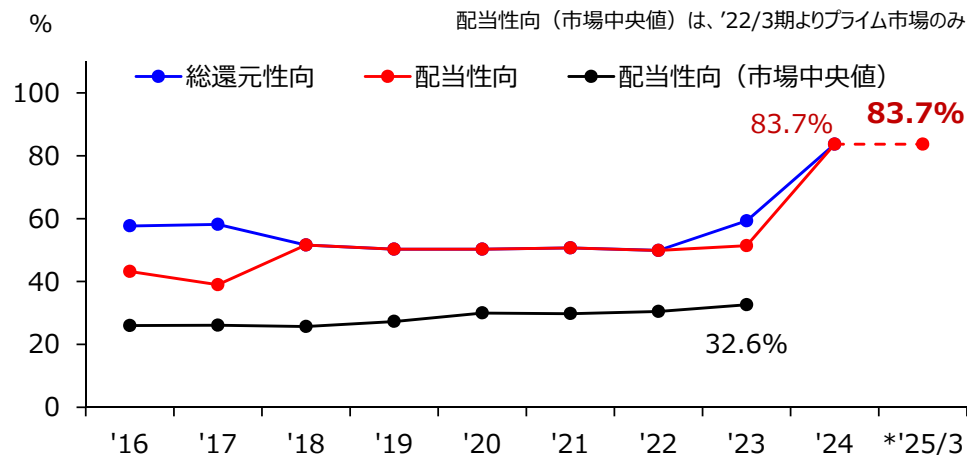
1株当たり当期純利益（分割前基準）



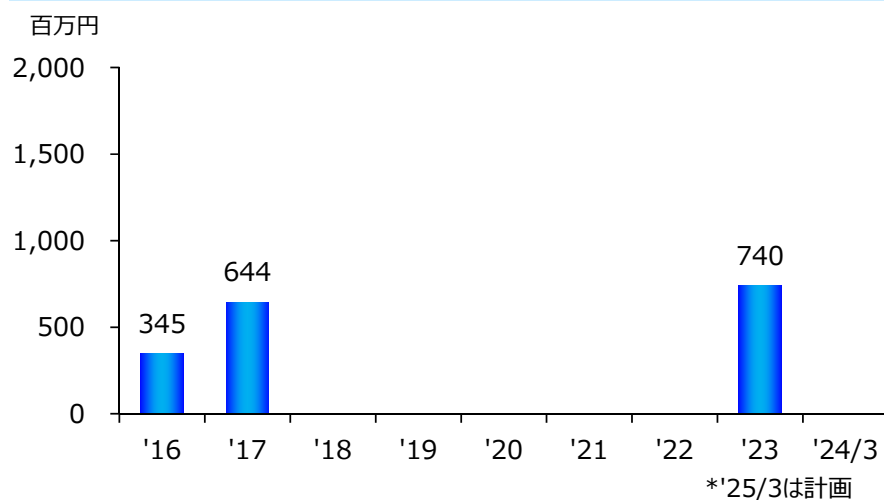
1株当たり配当金（分割前基準）



総還元性向・配当性向

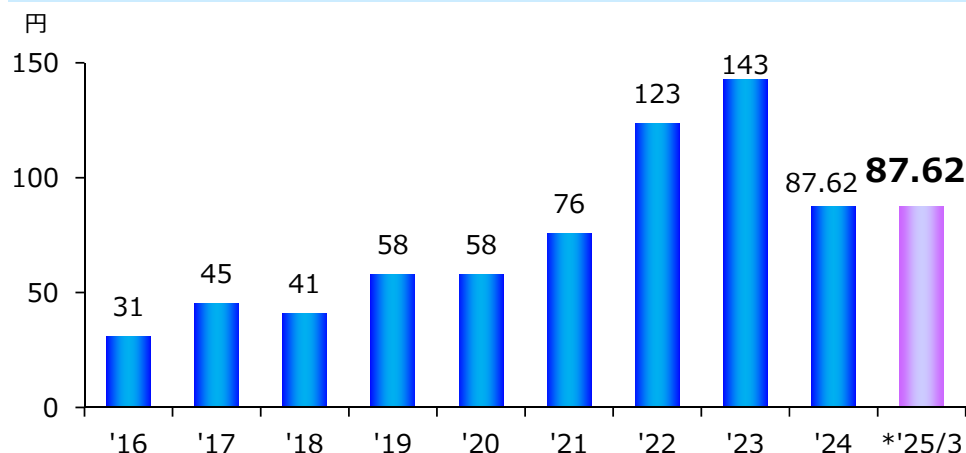


自己株買い

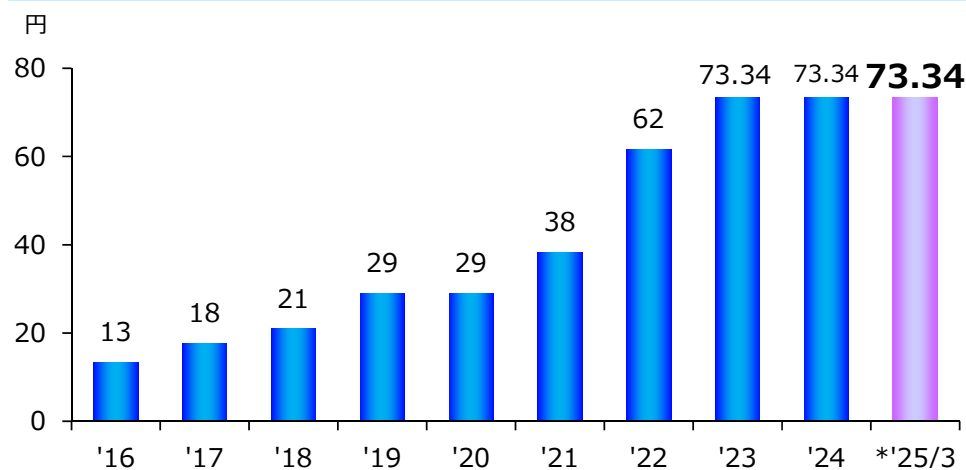


積極的な株主還元と安定配当の継続（分割後基準）

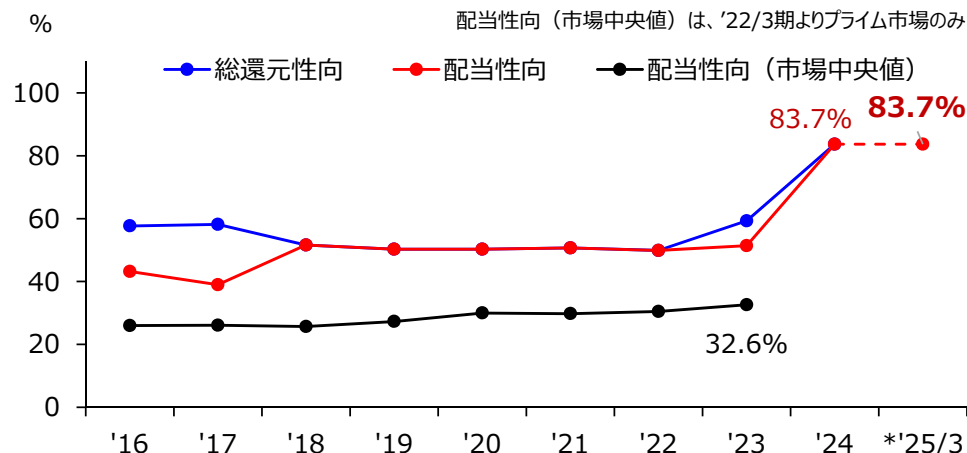
1株当たり当期純利益（分割後基準）



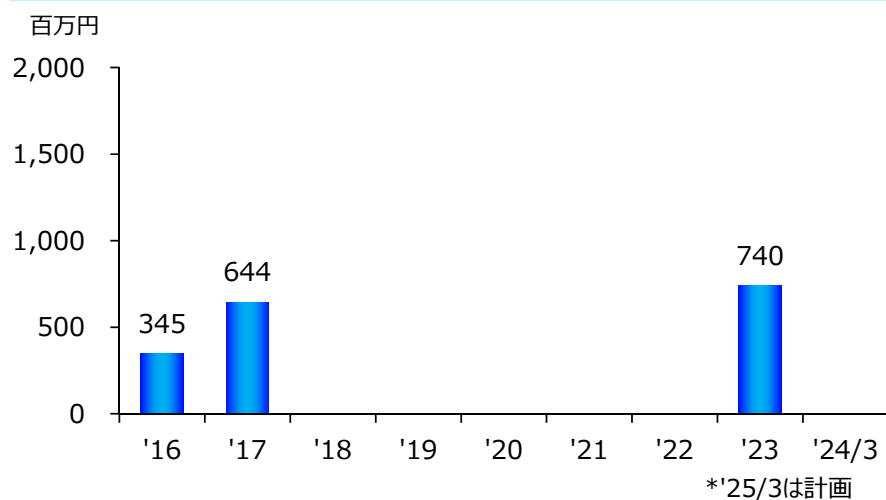
1株当たり配当金（分割後基準）



総還元性向・配当性向



自己株買い



2024年3月期 業績サマリー／2025年3月期 業績予想

【2024年3月期 業績サマリー】 *前期比

✓ 売上高	△11.9%*	: 半導体向け製品の販売減少に加え、原材料価格上昇の影響を受け、減収減益
✓ 営業利益	△37.7%	:
✓ 経常利益	△34.1%	:
✓ 当期純利益	△38.6%	:
✓ シリコンウェハー向け	△25.5%	: シリコンウェハーの生産調整が継続しラッピング・ポリシングは大幅減収
✓ CMP向け	△4.4%	: 上期のマチュアロジック、メモリでの稼働調整を受け、減収
✓ ハードディスク向け	△8.1%	: HDDの生産及び在庫の調整が継続し減収
✓ 一般工業用向け	△3.5%	: 産業機械及び半導体製造装置向けで減収
✓ 株主還元		: 減益となるも配当は据え置き

【2025年3月期 業績予想】

✓ 売上高	+6.4%	: 半導体の生産の本格的な回復には依然時間を要すものの緩やかな回復を想定し、増収を見込む
✓ 営業利益	+3.0%	: 将来の成長を見据えた先行的な費用増もあり、営業利益は微増を見込む
✓ 経常利益	△2.9%	: 前期の為替差益がなくなり、経常減益を見込む
✓ 当期純利益	+0.0%	: 前期の特別損失がなくなり、前期並みを見込む

技術を磨き、心をつなぐ

FUJIMI

FUJIMI INCORPORATED